

WBB-2000

KAIJO

Fully Automatic Thermo-sonic Wafer Level Bonder

超音波併用熱圧着(サーモソニック)方式高精度ウェハレベルボンダ

最大 12 インチウェハ対応
Up to 12-inch wafers



オプション装着仕様

Photograph shows specs with options

WBB-2000 の特長 FEATURES

- 大型ウェハの生産タクト大幅向上に貢献
Contributes to an improvement in takt time for large wafers
- 品種プログラミング作業が従来機比較 40%* の時間短縮
Recipe programming time is 40%* shorter than conventional models
- 新ウェハマップビューワによるマップデータのリアルタイム可視化と直感的な操作
Real-time visualization of map data and intuitive operation by a new Wafer-map-viewer
- ステップボンドシーケンスを搭載 可視化による直感的なパラメータ設定
Step-Bond-Sequence Intuitive parameter setting through visualisation
- トレーサビリティや自己診断、Industry4.0 に対応し、オンラインでの品質・設備管理が可能
Traceability, Self-diagnosis, Industry 4.0 compatibility, and Online product quality and equipment management

WBB-2000

■ 主な仕様

ボンディング性能	
ボンディング方式	超音波併用熱圧着（サーモソニック）方式
超音波発振方式	PLLによる発振周波数自動追尾、単周波
繰り返し位置精度	$3\sigma \leq 3.5\mu\text{m}/8\text{in}$ $3\sigma \leq 5\mu\text{m}/12\text{in}^*$
タクト時間	28msec/bump**
画像認識機能	
認識方式	形状認識方式（ α eyes）と多値化相関処理方法から選択可
検出速度	約100msec/2点（5mm角チップ） 約200msec/4点（5mm角チップ）
検出率	99%以上**
対応ワーク	
ウェハ	サイズ：4, 6, 8, 12インチ 厚さ：0.2mm～1.0mm
リング付きウェハ	リング幅：380mm
外部通信機能	
	SECS/GEM 搭載 KISS 搭載
ユーティリティ	
電源	単相 AC200V \pm 5%, 50Hz/60Hz, 8A ※210V, 220V, 230V, 240V, 100V はオプション 最大消費電力：約1.5kW
エア	圧力：0.3～0.970MPa（3～9.9Kgf/cm ² ）、ISOクラス5以上 消費量：40Liters/min以下
真空	圧力：-70kPa以下
装置諸元	
寸法	幅：1,110mm 奥行：1,330mm 高さ：1,740mm（警告灯上部までは2,200mm）
重量	約1,200kg

◆カタログ掲載商品の仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。

*セルフティーチ精度を除く。ウェハステージ（X軸駆動、Y軸駆動、 θ 軸回転）の移動量を含む。

**当社所定の条件下での算出値

■ SPECIFICATIONS

Bonding	
Process	Ultrasonic with thermocompression bonding
Oscillation	Frequency automatic tracking by PLL. Single frequency.
Repeatability of Bonding Accuracy	$3\sigma \leq 3.5\mu\text{m}/8\text{in}$ $3\sigma \leq 5\mu\text{m}/12\text{in}^*$
Takt time	28msec/bump**
Recognition	
Method	Shape recognition (α -eyes) or Multi-valued correlation processing (selectable)
Detection time	100msec/2 points (5mm square chip) 200msec/4 points (5mm square chip)
Detection rate	99% or more**
Applicable work size	
Wafer	Size: 4, 6, 8, 12in Thickness: 0.2mm~1.0mm
Wafer with ring	Ring width: 380mm
External interface	
	SECS/GEM KISS (Kaijo Interconnecting Service System)
Utility	
Power	Single phase AC200V \pm 5%, 50Hz/60Hz, 8A (210V, 220V, 230V, 240V, 100V option) Maximum power consumption: Approximately 1.5kW
Dry air	Pressure: 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²) ISO class 5 or more Consumption: 40Liters/min or less
Vacuum	Pressure: -70kPa or less
Dimensions	
Width	1,110mm
Depth	1,330mm
Height	1,740mm (To top of signal lamp: 2,200mm)
Weight	Approximately 1,200kg

◆Specifications is subject to change without prior notice.

*Excluding self-teach accuracy. Includes the amount of movement of the wafer stage (X-axis drive, Y-axis drive, θ -axis rotation).

** Calculated value under the conditions specified by KAIJO.



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION

東京都羽村市栄町 3-1-5 〒205-8607
3-1-5 Sakae, Hamura, Tokyo, JAPAN 2058607

URL <https://www.kaijo.co.jp>

ボンダー事業部

TEL. 042-555-6162

FAX. 042-579-5175

✉ bonder-info@kaijo.co.jp

● 国内営業（東日本） / Domestic Sales (Tokyo)

● 国内営業（西日本） / Domestic Sales (Osaka)

● 海外営業 / Overseas Sales

● カスタマーサポート・ヘルプデスク / Customer Support Help-desk

● 台湾海上希歩洋股份有限公司 / TAIWAN KAIJO SHIBUYA CORPORATION

● 上海楷捷半導体科技有限公司 / KAIJO SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO.,LTD.

● KAIJO SHIBUYA EUROPE GmbH (GERMANY)

● シンヤ カイジョー (タイランド) / SHIBUYA KAIJO(THAILAND) CO.,LTD.

● シンヤ カイジョー (マレーシア) / SHIBUYA KAIJO(MALAYSIA) SDN. BHD.

TEL.042-555-8889

TEL.06-4805-0231

TEL.042-555-0321 / +81-42-555-0321

TEL.042-555-4834 / +81-42-555-4834

TEL.+886-2-8712-2377

TEL.+86-21-6275-1515

TEL.+49-611-72429155

TEL.+66(0)2673-9496-8

TEL.+60(0)4-611-6040 (PENANG Office)

ご用命は